

ひっついて、熱を逃がしてやまない。

こんなお客様に

- ✓ モビリティ部品の発熱による性能低下にお悩み
- ✓ 密着不良による排熱性能低下にお悩み
- ✓ 低分子シロキサンフリー化を図りたい 等

ペースト提供形態



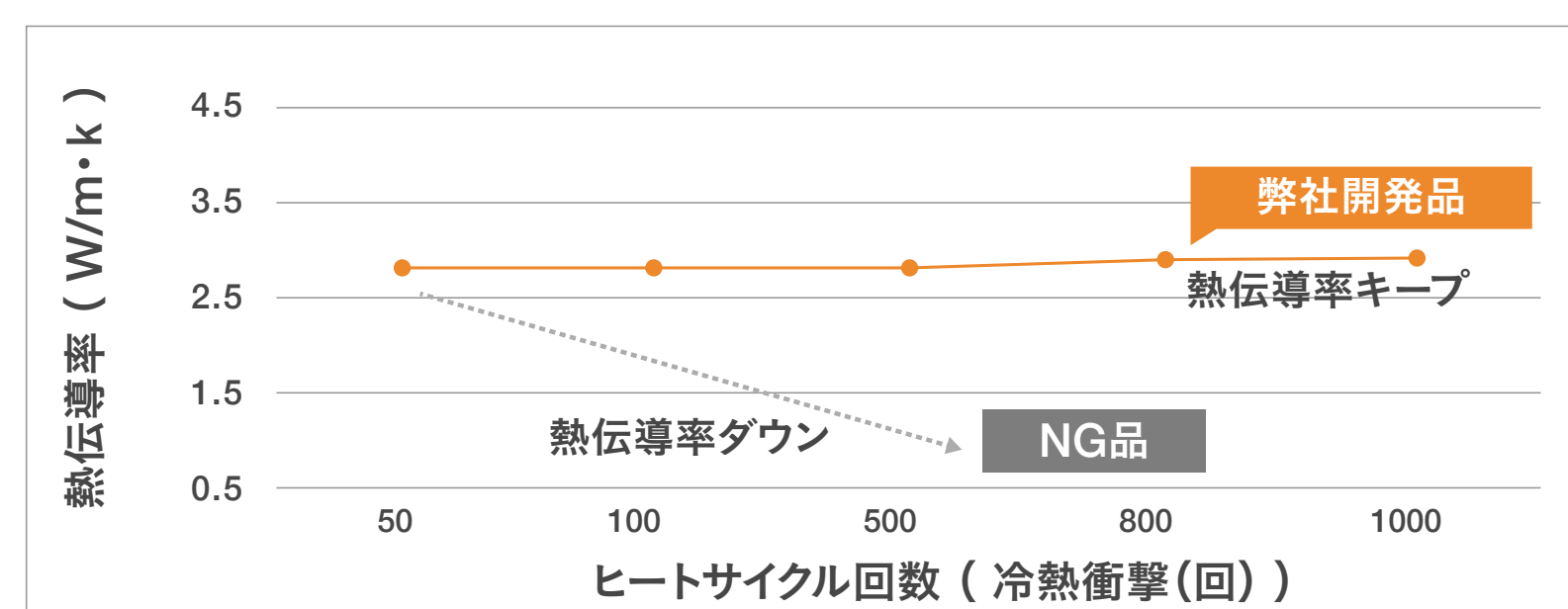
YG/YGFシリーズ特徴

01 | 製品ラインナップ

TYPE C1	低コストグレード	1.8W/m・K
TYPE C2	低熱伝導グレード	2.5W/m・K
TYPE O	中熱伝導グレード	3.2W/m・K
TYPE M	高熱伝導グレード	4.6W/m・K

* 測定方法 | ホットディスク法

02 | ヒートサイクル試験



* 1サイクル | 降温→▲40°C/30min→昇温→150°C/30min
温度条件 | ▲40~150°C

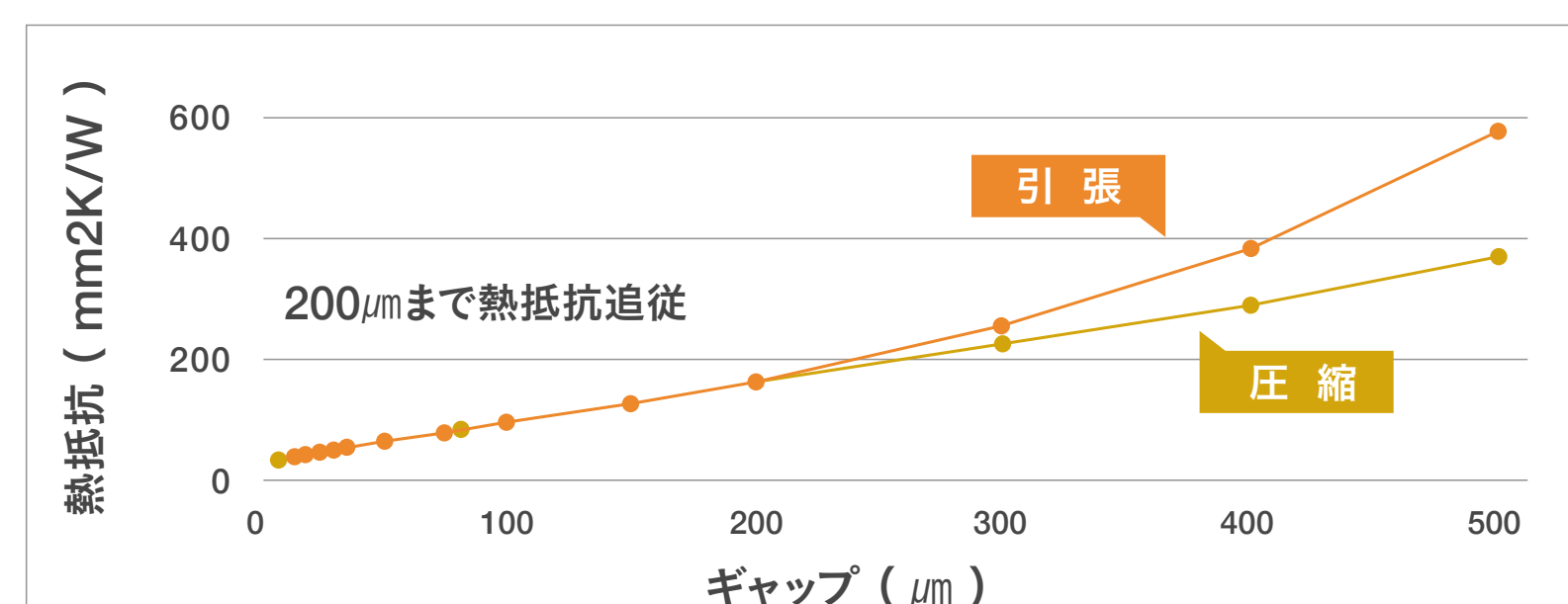
03 | 保管安定性



一般処方 弊社処方

* 保管条件 | 室温30日静置

04 | 追従性



* 測定方法 | TIMA5

本資料における各種物性データは、特定条件下における弊社評価結果ですので保証値ではありません。成形方法や成形条件、お取り扱い樹脂の特性により、測定結果が変わる可能性があります。

大日精化工業株式会社 / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

ファインポリマー事業部 開発課 TEL: 03-3665-5645 E-mail: fp_daicolor.co.jp-bounces@daicolor.co.jp